

# Técnicas de depósito aplicado a la fabricación de dispositivos semiconductores

Microcredencial 3 ECTS (10h aula + 20h lab.)

CÁTEDRA UPM – INDRA en MICROELECTRÓNICA

## ¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

1. Depósito de metales para contactos eléctricos en dispositivos de semiconductores:
  - i. Evaporación de metales por efecto Joule
  - ii. Evaporación de metales mediante haz de electrones
  - iii. Pulverización catódica
  - iv. Tratamientos térmicos: RTA, hornos de resistencias.
2. Depósito de materiales dieléctricos para el aislamiento entre niveles de un chip:
  - i. Pulverización catódica
  - ii. Depósito químico en fase vapor (LP-CVD, PE-CVD e ICP-CVD)
  - iii. Depósito de capas de tamaño atómico (ALD)
  - iv. Oxidación térmica



MATRÍCULA 100%  
GRATUITA.  
FINANCIADO POR  
CÁTEDRA  
UPM-INDRA

 10/01/2025 al 07/03/2025 (L y V) de 17:00h a 19:00h

 PRESENCIAL. Laboratorios del ISOM y aulas de la ETSI Telecomunicación

 [comunidad.microelectronica@upm.es](mailto:comunidad.microelectronica@upm.es)

**PREINSCRÍBETE**